



Flux en Pasta para Soldar 100g FLUXP-100P FERREQUIM

## Descripción

## **CARACTERÍSTICAS**



- Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.
- Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.
- Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.
- No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.
- Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.
- Debe utilizarse en equipos apagados.

## **VENTAJAS**

- Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.
- Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.
- Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.
- Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

## **ESPECIFICACIONES**

MODELO FLUXP-100P



**MARCA** 

**CONTENIDO** 

**TIPO** 

Ferrequim

100 gramos

Flux en Pasta

**CONTENEDOR** Frasco de plástico

